

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

鸿日达科技股份有限公司
投资者活动记录表

编号：2026-03

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他：（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中泰证券、中金公司、国盛证券、鑫元基金、太平养老保险、臻宜投资、贝寅基金等
时间	2026 年 7 月 10 日星期五
地点	东台润田精密科技有限公司（全资子公司）报告厅
公司接待人员姓名	董事会秘书：周毅先生 半导体材料事业部负责人：万敏阳先生 证券事务代表：刘禹楠女士
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1：关注到公司 7 月 9 号的调研纪要中关于半导体封装散热片材料项目的进展和扩产计划，想问一下公司当时是怎么进入到这个领域的？公司在该领域构建的模具能力、电镀能力和技术人才等方面的优势，是如何形成的，是否能构成足够宽的护城河？ 答：公司的半导体封装散热片团队在 2020 年开始产品开发，2022 年年底团队开始逐步加入鸿日达，2024 年上半年公司开始送样验证，2025 年逐

步获得部分国内头部封装厂的供应商代码（Vendor Code），并实现批量交货。2026 年上半年获得大陆境外头部客户的供应商代码并小批量交付，预计下半年开始批量交付。

公司在传统的连接器业务上积累了较深厚的模具与电镀方面的精密加工能力。在进入半导体封装散热片领域之后，公司进一步加大了研发与投入，并进行了资源整合，吸收了大量人才加盟，逐步形成了目前较宽的护城河。由于半导体封装散热片相关产品研发周期较长，客户验证严格且时间跨度大，公司目前在国产化替代方面已具备一定的先发优势。

问题 2：公司目前半导体封装散热片的产品结构大致是怎么样的？良率和毛利率处在什么水平？产品定价是否有优势？

答：公司的半导体封装散热片包括铜基系列散热片和不锈钢材质的 Ring 环产品，公司在产品工艺、材质方面仍在继续探索，根据客户要求不断进行开发与迭代。良率、毛利率以及产品定价与海外竞争对手处于同一水平。

问题 3：请问公司 3D 打印项目进展情况如何？

答：公司自研 3D 打印机台设备，主要用于部分消费电子结构件生产与散热器件的生产。目前相关技术已成熟，公司正在稳步扩产过程中。其中，消费电子业务预计在下半年可以实现稳定收入；散热器件方面在持续送样与验证过程中，具体经营情况公司将在定期报告或相关公告中按规定进行披露，欢迎投资人跟踪关注。

	问题 4：请问公司目前是否有在金刚石散热业务上的战略布局？ 答：公司高度重视金刚石在散热领域的应用与发展，并按部分客户要求积极进行了研发与打样送样。公司仍在对相关产品进行测试过程中，暂未具备规模化生产相关产品的能力。后续若公司在该领域拓展并构成重大投资的，公司将履行相关审核程序并以公告形式对外披露。 问题 5：请问公司 2026 年是否有股权激励计划？ 答：公司目前仍在执行 2023 年限制性股票激励计划，该计划考核包含 2026 年，设置了对应年度业绩考核目标，计划处于有效期内正常运行。公司目前暂未制订新的股权激励方案，后续会结合经营情况、人才需求、市场发展等要素进行综合评估，如有相关预案，公司会履行审核程序并及时公告。
附件清单	无
日期	2026 年 7 月 10 日